

2023年度精密工学会 秋季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 2023年 9月 13日(水)～15日(金)
2. 会 場 福岡工業大学(福岡県福岡市東区和白東3-30-1)
3. 講演申込開始 2023年 5月 17日(水) 9時 から
4. 講演申込締切 2023年 6月 7日(水) 17時 まで(締切厳守)
5. 講演論文原稿締切 2023年 7月 5日(水) 正 午 まで(締切厳守)
6. 講演論文集発行日 2023年 8月 31日(木) (オンラインによる公開, ダウンロード式)
7. 講演申込費用締切日 2023年 8月 31日(木) までにお納めください。

8. 講演発表資格

- 1) 個人会員(正会員・学生会員・学生会員 Web 級・名誉会員), 賛助会員所属の非個人会員および非会員・学生非会員の方の講演発表が可能です。なお 2018 年度春季大会より「精密工学会春秋大会 賛助会員参加無料券」での講演申込も可能となりました。

※「精密工学会春秋大会 賛助会員参加無料券」は賛助特級 AA～1 級までの賛助会員企業に配布しているもので, 詳しくは精密工学会ホームページ内の入会案内ページ掲載「会員特典と会員種別」(<https://www.jspe.or.jp/join/privilege/>)をご覧ください。

- 2) 講演発表者を代表として申し込んでいただきますが, 講演論文原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 本講演会について

- 1) 本講演会は, すべて対面でのセッションとなり, 講演プログラムに沿って会場講演室で発表・質疑応答を行います。
- 2) 従来と同等の講演論文集をオンラインにより配信します。CD-ROM の発行は行いません。
- 3) 日程の都合上, 締切延長措置は予定しておりませんので, 締切厳守にご協力いただけますようお願いいたします。

10. 講演申込について

- 1) 講演発表者のお名前でお申し込みください。講演に関する連絡や講演申込費用の請求書等郵送物の送付は講演発表者に行います。また, 申込ウェブページへのアクセスも講演発表者に限りますので, お申込後にやむを得ず変更される場合は, 必ずご連絡をお願いいたします。
- 2) 講演申込は, すべて精密工学会ウェブサイトから行っていただきます。特に今回は締切延長は予定しておりませんので, 講演申込締切期日厳守をお願いいたします。締切後直ちに作業を進めますので, 遅れたものは理由を問わず受け付けできません。なお, 精密工学会ウェブサイトには講演募集に関する最新情報を掲載します。
- 3) 申込先 <https://www.jspe.or.jp/> (精密工学会ウェブサイト)
(問合せ先) 公益社団法人 精密工学会 大会係
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2 階
E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp
- 4) 講演は 1 名で 2 件以上の申込みができますが, 講演 1 件につき 1 通の登録が必要です(講演 2 件をプログラム上に連続配置することも可能です。ご希望の場合は申込フォームの通信欄にその旨ご記入ください)。
- 5) 講演申込には下表の費用が必要です(費用はすべて税込)。

講演発表者 会員区分	申込件数	講演発表者 大会参加登録費(講演費) (すべて税込)	備 考
正 会 員	1 件目	11,000 円	講演発表者の大会参加登録費, 講演論文集含む
	2 件目以降	無料	同一発表者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
学生会員・ 学生会員 Web 級	1 件目	5,000 円	講演発表者の大会参加登録費, 講演論文集含む
	2 件目以降	無料	同一発表者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
賛助会員に所属 する非個人会員	1 件目	11,000 円	講演発表者の大会参加登録費, 講演論文集含む
	2 件目以降	無料	同一発表者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
非会員	1 件目	24,000 円	講演発表者の大会参加登録費, 講演論文集含む
	2 件目以降	無料	同一発表者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。
学生非会員	1 件目	11,000 円	講演発表者の大会参加登録費, 講演論文集含む
	2 件目以降	無料	同一発表者が 2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません。

送金方法：郵便振替・銀行振込

郵便振替：00180-3-6115 公益社団法人精密工学会

銀行振込：みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788 公益社団法人精密工学会

※大会参加登録費(講演費)の請求書は7月上旬までに発送の予定です(大会参加登録費(講演費)は2023年8月31日(木)までにお納めください)。

6) 非会員または学生非会員の方で、個人会員としての講演発表を希望される場合は、講演申込の受付期間中に会員入会手続きをお願いいたします。講演申込の受付締切後にご入会された場合、講演発表者の会員区分の変更はお受けできません。予めご了承ください。

7) 講演論文原稿は、PDF 原稿の書き方を参考に作成し、原稿締切日までに指定のウェブページから提出してください。原稿締切日を過ぎた講演論文原稿は受理できませんので、期日厳守にてお願いいたします。

8) 講演論文原稿および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

9) 講演論文集に収録された論文およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権、翻案権、翻訳権を含みます。

11. 講演申込の方法

1) 講演申込は、精密工学会ウェブサイトフォームに沿って登録してください。

2) 同一題目の第1報～第n報には必ず副題を入れてください。

3) 講演要旨はそのまま講演論文集およびアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を200字以内で書いてください。

4) 講演希望セッションについて

本講演会における講演セッションについては、別紙一覧表の通りです。申し込みの際は一覧表を確認の上、

講演希望セッション名を選択してください。講演希望セッションの選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりません。また、講演申込締切日を過ぎてからの講演希望セッションの変更はできませんので、申込内容を必ず確認いただきますようお願いいたします。

12. 講演プログラムについて

講演プログラムは、その編成権を本会学術交流委員会がもち、責任をもって最終決定いたします。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、予めご承知おきください。また、講演プログラムは原則として変更できません。

13. 講演発表に関するお願いと注意

- 1) 講演発表1件あたりの講演時間は15分です（発表最大10分、討論、発表切替の合計で15分）。
- 2) 同一講演発表者が同一セッションに3件以上の講演を申し込むことはご遠慮ください。
- 3) 同一題目で3件以上の講演はご遠慮ください。
- 4) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前をお願いいたします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、講演発表者の責任で対処していただくようお願いいたします。

14. 講演発表者変更および講演申込の取消について

- 1) 講演申込時の題目・講演発表者の変更は原則として認めません。やむを得ず変更される場合は必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合は、講演申込時の題目・講演発表者情報を製作物に記載いたします。
- 2) 講演申込締切日を過ぎての申込キャンセルは原則として認めません。必ず講演論文を提出のうえ、発表いただきます。講演発表者が病気や事故等のやむを得ない理由で講演論文の作成および発表が出来ない場合は、連名者が代わりに対応いただくようお願いいたします。この点については、講演申込の前に連名者に必ずご確認ください。

15. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

従来と同様に、特に優れた発表について「ベストプレゼンテーション賞」を講演発表者にお出しします。本賞は35歳までの若手講演発表者を審査対象（キーノートスピーカを除く）として、講演総数の概ね10%に贈賞いたします。詳細につきましては、後日、精密工学会ウェブサイト（<https://www.jspe.or.jp/>）に掲載しますのでご覧ください。

16. 学生研究発表会について

9月13日（水）（大会1日目）午後に学生会員（学生会員Web級含む）、高専生による研究発表会をポスター形式で開催いたします。詳細は2023年度秋季大会サイト「学生研究発表会」でご案内いたします。

17. その他

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況（その他不測の事態が生じた場合）により、開催日時、実施方法等が変更される可能性があります。

2023年度精密工学会秋季大会学術講演会 講演セッション一覧

<分類表> ※2018年度春季大会より以下の分類に変更となりました。

A：設計・生産システム

B：精密加工

C：メカトロニクス・精密機器

D：精密計測

E：人・環境工学

F：材料・表面プロセス

G：バイオエンジニアリング

H：ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
A	01	OS	形状モデリングの基礎と応用	大竹 豊(東京大), 吉澤 信(理化学研), 道川 隆士(理化学研), 森口 昌樹(中央大), 長井 超慧(東京都立大)	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	OS	デジタルスタイルデザイン	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	OS	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研), 福重 真一(早稲田大)	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニュファクチャリング
A	04	OS	サイバーフィールド構築技術	石川 貴一朗(日本工業大), 増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大), 溝口 知広(日本大)	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	OS	オープン指向のCAD/CAM開発	浅川 直紀(金沢大), 乾 正知(茨城大), 金子 順一(埼玉大), 高杉 敬吾(金沢大)	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	OS	金型設計・生産技術	村田 泰彦(日本工業大), 楡原 弘之(九州工業大), 新川 真人(岐阜大), 福島 祥夫(埼玉工業大)	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	山本 雅人(北海道大), 成瀬 継太郎(会津大), 林 朗弘(九州工業大)	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	OS	システムのシンセシス(設計・サービス・生産システム)	下村 芳樹(東京都立大), 岩村 幸治(大阪府立大), 千葉 龍介(旭川医科大), 妻屋 彰(岡山県立大), 長井 超慧(東京都立大), 野間口 大(大阪大), 藤井 信忠(神戸大), 森永 英二(大阪公立大), 筒井 優介(岡山県立大)	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS(Product-Service Systems), 製品サービスシステム, 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	01	OS	工作機械の高速高精度化	吉岡 勇人(東京大), 松原 厚(京都大), 林 晃生(金沢工業大), 千田 治光(オクマ)	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	OS	高能率・高精度化のための切削工具	關谷 克彦(広島大), 高橋 亘(三菱マテリアル), 笹原 弘之(東京農工大), 手塚 亮(牧野フライス製作所)	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	OS	多軸制御加工計測	森重 功一(電気通信大), 茨木 創一(広島大), 中本 圭一(東京農工大)	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄(九州大)	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	OS	超音波振動を援用した加工技術	神 雅彦(日本工業大), 磯部 浩巳(長岡技科大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	OS	研削現象とその機構	大橋 一仁(岡山大), 山田 高三(日本大), 藤本正和(近畿大)	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	OS	超砥粒ホイール応用加工技術の新展開	岩井 学(富山県立大), ニノ宮 進一(日本工業大), 澤 武一(芝浦工業大), 太田 稔(京都工芸繊維大)	超砥粒ホイール, 研削, ツルレーン・ドレッシング, 研削盤
B	08	OS	曲面・微細形状の超精密加工と計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(東京電機大), 古城直道(関西大), 林 偉民(群馬大), 柿沼 康弘(慶應義塾大), 鈴木 浩文(中部大), 三浦 勝弘(MATE), 福田 将彦(芝浦機械)	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	10	OS	切断加工	諏訪部 仁(金沢工業大), 坂本 智(横浜国立大)	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	11	OS	砥粒加工の新展開	佐竹 うらら(大阪大), 桐野 宙治(クリスタル光学), 榎本 俊之(大阪大)	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	OS	複合研磨	川久保 英樹(信州大), 鄒 艶華(宇都宮大), 西田 均(富山高専), 佐藤 隆史(IHI), 久住 孝幸(秋田県産業技術センター)	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	畝田 道雄(金沢工業大), 黒河 周平(九州大), 森永 均(フジインコーポレーテッド)	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	OS	電気エネルギー応用加工	早川 伸哉(名古屋工業大), 金子 健正(長岡高専)	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	OS	レーザー加工	山口 貴(金沢大学), 上野原 努(大阪大), 比田井 洋史(千葉大)	レーザー加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	OS	先進切削技術	松村 隆(東京電機大), 金子 順一(埼玉大), 吉川 浩一(九州工業大), 杉田 直彦(東京大)	切削機構, 切削温度, 工具摩耗, 仕上げ面評価, 切削状態監視, 知能化切削, 切削シミュレーション

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
B	17	OS	機能形状創製 (付加製造, 3Dプリンティング, MID)	新野 俊樹(東京大)	付加製造, 3Dプリンティング, MID
B	19	OS	加工のデータサイエンスとAI	澤 武一(芝浦工業大), 吉原 信人(岩手大), 児玉 紘幸(岡山大), 尾島 裕隆(茨城大)	データサイエンス, AI, IoT, DX
B	99	一般	精密加工一般		
C	01	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二(豊橋技術科学大), 若園 賀生(ジェイテクト), 佐藤 隆太(名古屋大)	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	OS	次世代センサ・アクチュエータ	森田 剛(東京大), 岩附 信行(東京工業大), 古谷 克司(豊田工業大), 笠島 崇(日本特殊陶業)	機能性材料を応用したセンサ・アクチュエータ, 新原理によるセンサ・アクチュエータ, 超音波デバイスとその応用, センサ・アクチュエータ制御手法
C	03	OS	ロボティクス・メカトロニクス	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大), 本田 智(東京都立大), 山本 晃生(東京大)	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	05	OS	マイクロ生産機械システム	長谷 亜蘭(埼玉工業大), 金子 義幸(高松機械工業), 古谷 克司(豊田工業大)	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化, 微小部品加工
C	99	一般	メカトロニクス・精密機器一般		
D	01	OS	光応用技術・計測	水谷 康弘(大阪大), 石原 満宏(東光高岳), 西島 直樹(バルステック工業), 若山 俊隆(埼玉医科大)	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	OS	知的精密計測	高谷 裕浩(大阪大), 高橋 哲(東京大), 高橋 顕(ニコン), 中村 吉助(小坂研究所), 清水 裕樹(北海道大)	知的計測
D	03	OS	画像技術と産業システム応用	李 媛(日立製作所), 山下 淳(東京大学), 水谷 彰宏(日本ガイシ)	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	OS	X線光学のための精密技術	松山 智至(名古屋大), 湯本 博勝(高輝度光科学研セ), 木村 隆志(東京大)	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リソグラフィ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
D	99	一般	精密計測一般		
E	01	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎(東京大), 太田 裕治(お茶の水女子大), 垣本 映(職能開発総合大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	OS	生産原論	伊藤 伸英(茨城大), 池野 順一(埼玉大), 林 偉民(群馬大), 河西 敏雄(河西研磨技術特別研究室/埼玉大), 伊藤 昌樹(関東職能開発大), 永野 善己(関東職能開発大)	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
E	99	一般	人・環境工学一般		
F	01	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 平田 敦(東京工業大), 坂本 仁志(クリエイティブコーティングス)	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	99	一般	材料・表面プロセス一般		
G	01	OS	マイクロニードル(作製法とアプリケーション)	青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大), 金 範峻(東京大), 加藤 暢宏(近畿大)	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	OS	バイオ・医療への応用展開	柴田 隆行(豊橋技科大), 初澤 毅(東京工業大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(東京都立大), 青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大),	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
G	99	一般	バイオエンジニアリング一般		
H	01	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	金子 新(東京都立大), 角田 陽(東京高専), 比田井 洋史(千葉大), 清水 淳(茨城大), 倉本 智史(島津製作所)	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	OS	マイクロ/ナノシステム	中里 裕一(日本工業大), 伊藤 高廣(九州工業大), 寺田 英嗣(山梨大学), 松井 伸介(千葉工業大), 見崎 大悟(工学院大), 本田 智(東京都立大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニファクチャリングシステム, アセンブリングシステム, デザインシステム
H	03	OS	MEMS商業化技術	尹 成園(産総研), 小久保 光典(芝浦機械), 村上 直(九州工業大), 藤野 真久(産総研), 岩崎 渉(産総研)	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント, 電子ビーム描画技術
H	04	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	押鐘 寧(大阪大学), 有馬 健太(大阪大), 伊東 聡(富山県立大), 桑原 裕司(大阪大学)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
H	99	一般	ナノテクノロジー・新領域一般		

1) オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は、講演を希望する分類・コード・セッション名を必ず選択してください。選択漏れ、選択ミスがあるとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。なお、講演申込締切日を過ぎてからの講演希望セッションの変更はできません。

2) プログラム編成は、その編成権を学術交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になる場合もありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。